

研究成果報告書 (掲載期間 2022.11.1－2023.10.31)

学術書

- (1) 山田靖他：次世代半導体パッケージの最新動向とその材料、プロセスの開発，第 4 章第 7 節 pp.284-295，技術情報協会，2023.

審査学術論文

- (1) 山田靖，八坂慎一，大浦賢一，東条三秋：パワー半導体実装用接合材料の基礎物性と信頼性の評価法，エレクトロニクス実装学会誌，26 巻，2023，1 号，pp.158-166.

学術論文

- (1) 山田靖：パワーデバイス実装用高放熱グラフィート，車載テクノロジー，10 巻，2023，5 号，pp.28-35.

学会発表

- (1) 松永いずみ，安部登惟，奥村惇史，村瀬葵，田中颯，山田靖：パワー半導体実装用接合材料の高温・高電流密度での信頼性評価，エレクトロニクス実装学会，第 33 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2023)，2023 年 9 月，名古屋.
- (2) 山田靖，八坂慎一，伊勢谷健司，東条三秋，大竹康久：パワー半導体高温動作用実装構造の信頼性，エレクトロニクス実装学会，第 33 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2023)，2023 年 9 月，名古屋.
- (3) 高橋昭雄，羽深等，山田靖，唐澤志郎：KAMOME PJ の 12 年の成果と新しい展開，エレクトロニクス実装学会，第 33 回マイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES2023)，2023 年 9 月，名古屋.